

最新 3D スキャナ 体験セミナー

— ZEISS 社最新カメラ式 / ハンディ式 3D スキャナ操作体験 —

2025 金

2/28

13:30-16:30

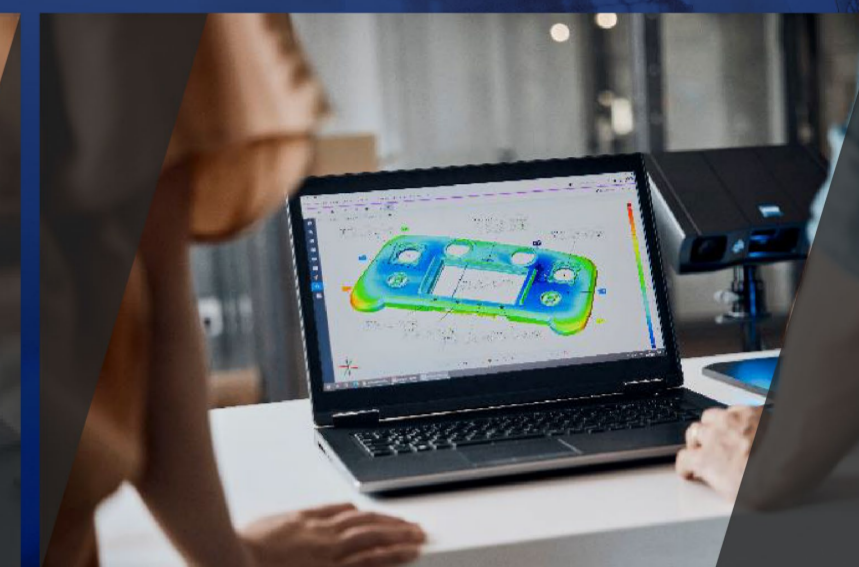
参加費無料



低価格エントリーモデル
「GOM Scan 1」



ZEISS Inspect 検査
リバースエンジニアリング



高機能ハンディスキャナ
「T-SCAN hawk2」

【開催概要】

デジタル化が進む昨今、3次元情報を取り込む技術である“3Dスキャン”もあらゆる業界で活用されています。

本セミナーでは3Dスキャンの基礎や最新の動向だけでなく、3Dスキャナのデモや操作体験を通じて最新の3Dスキャン技術を知って頂きます。それにより企業の測定/検査における困りごとの気づき・解消に寄与したいと考えています。

【開催日時】

2025年2月28日（金）13:30～16:30 ※受付は13:10より開始

【開催場所】

宮城県産業技術総合センター 大会議室
仙台市泉区明通2丁目2番地

【定員】

20名程度

【講師】

丸紅情報システムズ株式会社

【参加費】

無料

#HandsOn
Metrology / Tour

【プログラム】

13:30～14:00	3Dスキャンの基礎と最新動向／事例紹介
14:00～14:20	ライブデモ① カメラ式スキャナ 「GOM Scan 1」
14:20～14:40	ライブデモ② ハンディ式スキャナ 「T-SCAN hawk2」
14:40～15:00	Geomagic Design Xでできるリバースエンジニアリング
	【15:00～15:10 休憩】
15:10～16:10	操作体験ワークショップ
16:10～16:30	Q&A、アンケート記入等

※プログラムは進行の関係上、前後する可能性があります。

【お申込先】

https://www.mit.pref.miyagi.jp/event/20250228_3dscan
※申込期限：2025年2月27日（木）

【お問合せ】

宮城県産業技術総合センター 商品開発支援班
TEL：022-377-8700 / E-mail: kensyu@mit.pref.miyagi.jp

